

中国集成电路封测行业现状深度研究与投资前景 分析报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国集成电路封测行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202410/730487.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、消费电子需求回暖，半导体复苏，全球集成电路封测规模有望进一步扩大

集成电路封装，是用特定材料、工艺技术对芯片进行安放、固定、密封，保护芯片性能，并将芯片上的接点连接到封装外壳上，实现芯片内部功能的外部延伸。集成电路芯片封装完成后，需要进行性能测试，以确保封装的芯片符合性能要求。集成电路芯片封装完成后，需要进行性能测试，以确保封装的芯片符合性能要求。

数据显示，2023年全球集成电路封测市场规模约为 822 亿美元。消费电子需求回暖，带动半导体行业复苏，全球集成电路封测市场规模将保持增长。预计2024年全球集成电路封测市场规模有望增长9.4%到899 亿美元，2026年全球集成电路封测市场规模将进一步达到 961 亿美元。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据显示，2024年Q2 全球智能手机出货量达到 2.89 亿部，同比增长 12%，连续三个季度实现增长。在库存水平恢复、进口限制放宽和经济环境改善的推动下，2024 年智能手机市场有望实现中个位数增长。2024年Q2 全球 出货量同比增长3.1%，达到6250万台。得益于 AI 需求 and 新冠疫情后的更新换代周期，预计2024 年PC出货量有望实现 3%增长。2024年Q2 全球半导体行业销售额 1499 亿美元，同比增长 18.3%，环比增长 6.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

二、先进封装是提升芯片性能的关键，AI驱动下市场快速渗透

摩尔定律指在功耗不增加的前提下，每隔18 个月集成电路单位面积内晶体数量翻倍。自 2008 年 45nm 节点以来，台积电只能做到每隔3 年让AMD的CPU内核晶体管密度翻倍，能效要每隔 3.6 年才能实现翻倍。当前，摩尔定律面临以下瓶颈：

资料来源：观研天下整理

先进封装是超越摩尔定律、提升芯片性能的关键。随着硅芯片将达到物理极限，通过缩小晶体管实现芯片性能提升成本越来越高。以芯粒异质集成为核心的先进封装技术，成为了集成电路发展的关键路径和突破口。相比传统封装，先进封装具有小型化、轻薄化、高密度、低

功耗和功能融合等优点，不仅可以提升性能、拓展功能、优化形态、降低成本。目前最有代表性且已经实现大规模量产的先进封装是采用 TSMC CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) 封装形式的英伟达 GPU 芯片。

在AI驱动下，先进封装快速渗透。存储器的“存储墙”限制了计算芯片性能的发挥，GDDR5的带宽极限为 32GB/s。通过先进封装，将 HBM 和处理器集成，可以突破带宽瓶颈（HBM1和 HBM2 的带宽分别为 128GB/s 和 256GB/s），显著提升芯片性能。生成式AI 热潮持续带动全球 AI 服务器出货快速成长，先进封装也迎来发展机遇。

根据数据，2024 年全球 AI 服务器出货量约为194.2 万台，2027 年全球 AI 服务器出货量将达 320.6 万台。

数据来源：观研天下数据中心整理

全球先进封装市场规模有望从

2022年的468.3亿美元增长到2028年的785.5亿美元，先进封装占封装市场的比重由 2022 年的 46.6%提升至2028 年的54.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国集成电路封测厂商具备全球竞争力，长电科技市占率排名领先

我国封测厂商具备全球竞争力。目前，全球委外封测厂商主要分布在中国大陆和中国台湾地区。

数据显示，2023 年全球前十大委外封测公司中，五家中国台湾企业（日月光、力成科技、京元电子、南茂科技、颀邦）市占率为 37.73%；中国大陆厂商长电科技、通富微电、华天科技、智路封测合计市占率25.83%，长电科技市占率排名全球第三、国内第一；安靠科技（美资）市占率14.09%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国集成电路封测行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031

年)》涵盖行业最新数据,市场热点,政策规划,竞争情报,市场前景预测,投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构,拥有资深的专家团队,多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告,客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业,并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国集成电路封测行业发展概述

第一节 集成电路封测行业发展情况概述

- 一、集成电路封测行业相关定义
- 二、集成电路封测特点分析
- 三、集成电路封测行业基本情况介绍
- 四、集成电路封测行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式
- 五、集成电路封测行业需求主体分析

第二节 中国集成电路封测行业生命周期分析

- 一、集成电路封测行业生命周期理论概述
- 二、集成电路封测行业所属的生命周期分析

第三节 集成电路封测行业经济指标分析

- 一、集成电路封测行业的赢利性分析
- 二、集成电路封测行业的经济周期分析
- 三、集成电路封测行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球集成电路封测行业市场发展现状分析

第一节 全球集成电路封测行业发展历程回顾

第二节全球集成电路封测行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲集成电路封测行业地区市场分析

- 一、亚洲集成电路封测行业市场现状分析
- 二、亚洲集成电路封测行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲集成电路封测行业市场前景分析

第四节北美集成电路封测行业地区市场分析

- 一、北美集成电路封测行业市场现状分析
- 二、北美集成电路封测行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美集成电路封测行业市场前景分析

第五节欧洲集成电路封测行业地区市场分析

- 一、欧洲集成电路封测行业市场现状分析
- 二、欧洲集成电路封测行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧洲集成电路封测行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界集成电路封测行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球集成电路封测行业市场规模预测

第三章 中国集成电路封测行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对集成电路封测行业的影响分析

第三节中国集成电路封测行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规
- 三、主要行业标准

第四节政策环境对集成电路封测行业的影响分析

第五节中国集成电路封测行业产业社会环境分析

第四章 中国集成电路封测行业运行情况

第一节中国集成电路封测行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节中国集成电路封测行业市场规模分析

- 一、影响中国集成电路封测行业市场规模的因素
- 二、中国集成电路封测行业市场规模
- 三、中国集成电路封测行业市场规模解析

第三节中国集成电路封测行业供应情况分析

一、中国集成电路封测行业供应规模

二、中国集成电路封测行业供应特点

第四节中国集成电路封测行业需求情况分析

一、中国集成电路封测行业需求规模

二、中国集成电路封测行业需求特点

第五节中国集成电路封测行业供需平衡分析

第五章 中国集成电路封测行业产业链和细分市场分析

第一节中国集成电路封测行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、集成电路封测行业产业链图解

第二节中国集成电路封测行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对集成电路封测行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对集成电路封测行业的影响分析

第三节我国集成电路封测行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国集成电路封测行业市场竞争分析

第一节中国集成电路封测行业竞争现状分析

一、中国集成电路封测行业竞争格局分析

二、中国集成电路封测行业主要品牌分析

第二节中国集成电路封测行业集中度分析

一、中国集成电路封测行业市场集中度影响因素分析

二、中国集成电路封测行业市场集中度分析

第三节中国集成电路封测行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国集成电路封测行业模型分析

第一节中国集成电路封测行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节中国集成电路封测行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会
- 五、行业威胁
- 六、中国集成电路封测行业SWOT分析结论

第三节中国集成电路封测行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国集成电路封测行业需求特点与动态分析

第一节中国集成电路封测行业市场动态情况

第二节中国集成电路封测行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节集成电路封测行业成本结构分析

第四节集成电路封测行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

第五节中国集成电路封测行业价格现状分析

第六节中国集成电路封测行业平均价格走势预测

- 一、中国集成电路封测行业平均价格趋势分析
- 二、中国集成电路封测行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国集成电路封测行业所属行业运行数据监测

第一节中国集成电路封测行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国集成电路封测行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国集成电路封测行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国集成电路封测行业区域市场现状分析

第一节中国集成电路封测行业区域市场规模分析

- 一、影响集成电路封测行业区域市场分布的因素
- 二、中国集成电路封测行业区域市场分布

第二节中国华东地区集成电路封测行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区集成电路封测行业市场分析
 - (1) 华东地区集成电路封测行业市场规模
 - (2) 华东地区集成电路封测行业市场现状
 - (3) 华东地区集成电路封测行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析

三、华中地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 华中地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 华中地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 华中地区集成电路封测行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区集成电路封测行业市场分析
 - (1) 华南地区集成电路封测行业市场规模
 - (2) 华南地区集成电路封测行业市场现状
 - (3) 华南地区集成电路封测行业市场规模预测

第五节华北地区集成电路封测行业市场分析

- 一、华北地区概述
- 二、华北地区经济环境分析
- 三、华北地区集成电路封测行业市场分析
 - (1) 华北地区集成电路封测行业市场规模
 - (2) 华北地区集成电路封测行业市场现状
 - (3) 华北地区集成电路封测行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

- 一、东北地区概述
- 二、东北地区经济环境分析
- 三、东北地区集成电路封测行业市场分析
 - (1) 东北地区集成电路封测行业市场规模
 - (2) 东北地区集成电路封测行业市场现状
 - (3) 东北地区集成电路封测行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

- 一、西南地区概述
- 二、西南地区经济环境分析
- 三、西南地区集成电路封测行业市场分析
 - (1) 西南地区集成电路封测行业市场规模
 - (2) 西南地区集成电路封测行业市场现状
 - (3) 西南地区集成电路封测行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

- 一、西北地区概述
- 二、西北地区经济环境分析

三、西北地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 西北地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 西北地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 西北地区集成电路封测行业市场规模预测

第十一章 集成电路封测行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国集成电路封测行业发展前景分析与预测

第一节中国集成电路封测行业未来发展前景分析

一、集成电路封测行业国内投资环境分析

二、中国集成电路封测行业市场机会分析

三、中国集成电路封测行业投资增速预测

第二节中国集成电路封测行业未来发展趋势预测

第三节中国集成电路封测行业规模发展预测

一、中国集成电路封测行业市场规模预测

二、中国集成电路封测行业市场规模增速预测

三、中国集成电路封测行业产值规模预测

四、中国集成电路封测行业产值增速预测

五、中国集成电路封测行业供需情况预测

第四节中国集成电路封测行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国集成电路封测行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国集成电路封测行业进入壁垒分析

一、集成电路封测行业资金壁垒分析

二、集成电路封测行业技术壁垒分析

三、集成电路封测行业人才壁垒分析

四、集成电路封测行业品牌壁垒分析

五、集成电路封测行业其他壁垒分析

第二节集成电路封测行业风险分析

一、集成电路封测行业宏观环境风险

二、集成电路封测行业技术风险

三、集成电路封测行业竞争风险

四、集成电路封测行业其他风险

第三节中国集成电路封测行业存在的问题

第四节中国集成电路封测行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国集成电路封测行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国集成电路封测行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国集成电路封测行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节集成电路封测行业营销策略分析

一、集成电路封测行业产品策略

二、集成电路封测行业定价策略

三、集成电路封测行业渠道策略

四、集成电路封测行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202410/730487.html>